



Applied Ventures (AV) and Industrial Technology Investment Corporation (ITIC) – The 2019 Deep Tech Challenge

Collaborating with Deep Technology Startups in Taiwan to Make Possible™

關於 The 2019 Deep Tech Challenge

The 2019 Deep Tech Challenge 是由全球材料工程解決方案及半導體科技龍頭應用材料的應材創投 (Applied Ventures) 及創新工業技術移轉股份有限公司 (ITIC) 共同舉辦的創新競賽，此競賽邀請所有半導體、人工智慧&大數據、智慧製造、面板技術、能源技術及生命科學等相關領域科技之新創團隊一起參加，而入圍前 3 名的新創團隊不只將有機會獲得獎金，更可能贏得應材創投或創新工業技術移轉股份有限公司的長期投資，潛在投資金額每案介於 50 萬 - 500 萬美元，為台灣新創生態投入更多資源，鼓勵更多科技人才勇敢追夢！

主辦單位

應用材料 (Applied Materials)

美商應用材料公司是全球提供材料工程解決方案的領導者，全球幾近每顆新式晶片與先進顯示器都有我們應材設備的足跡。我們運用專業技術，以工業規模在原子層調整材料，協助客戶實現可能。在應用材料公司，我們的創新能驅動科技並成就未來。

深及廣的科技實力

應材在產業裡保持著最廣也最具深度的科技組合之一，並以此創造和改良材料的電子、物理、機械及光學特性。透過高度精密且複雜的沉積、蝕刻、改良及分析方法，我們應材能夠以工業的規模在原子層調整及操作材料。

- 原子層沉積 (ALD)
- 電化學沉積 (ECD)
- 測量與檢測 (Metrology & Inspection)
- 化學機械平坦化 (CMP)
- 磊晶 (Epitaxy)
- 物理氣相沉積 (PVD)
- 化學氣相沉積 (CVD)
- 蝕刻製程 (Etch)
- 快速熱處理 (RTP)
- 離子佈值摻雜 (Ion Implantation)

世界第一 半導體及顯示器設備製造商



營收
173億美元



研發投入
20億美元



專利
>12,500件



那斯達克上市公司
代號 AMAT



總公司位於
加州矽谷



~21,000位員工
17個國家
93個服務據點



應材創投 (Applied Ventures)


應材創投是應用材料的創業投資部門。過去十年內，應材創投已投資的創新公司包括智慧型手機、AR/VR、人工智能、自駕車、大數據、生物科技、3D 列印、機器人、綠色能源和先進材料等產業。應材創投的投資範疇包含所有階段型的募資，全球的投資金額可高達每年五千萬美金。我們應材創投目前已在十三個國家投資超過八十家公司。

創新工業技術移轉股份有限公司 (ITIC)

創新工業技術移轉股份有限公司 (ITIC) 成立於 1979 年，為台灣最有歷史和聲望的創投公司之一，目前已在世界各地投資超過數億美金，曾協助培育的公司總市值超過 2,000 億美元，其中包括聯華電子、友達光電和台積電等全球首家專用 IC 代工廠。

ITIC 對新創團隊的價值主要來自兩大優勢：首先是龐大的技術能量。ITIC 為著名的工業技術研究院 (ITRI) 子公司，工研院擁有超過 6,000 名技術專家和 25,000 項涵蓋機器人技術、先進材料和生物技術等專利，投入資源進一步支持新創公司具競爭力的研發和創新。第二個優勢是遍佈全球並快速增長的資源。ITIC 與世界級製造商、頂尖大學、研究機構、天使投資人和企業領袖網絡和國家級基金等策略夥伴建立了強大的網絡，無論創業公司有何需求，ITIC 皆能依據需求量身定制精確的協助模式。

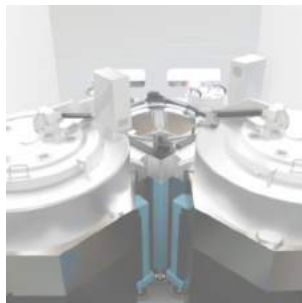
比賽階段



| 上網報名 | 說明會 | 簡報訓練 | 決賽簡報日 | 投資 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 請點選 這裡 報名，並提交初步提案及企業介紹 | 應材創投及 ITIC 將在台灣舉辦數場說明會，詳細資訊將盡快公布 | 10 隊晉級決賽的新創將有機會與投資人見面並獲邀參加簡報訓練 | 晉級決賽之新創團隊將於當天向投資人及產業專家進行產品簡報 | 如提案產品通過驗證調查，AV 和/或 ITIC 將評估該公司為投資候選人 |

此競賽主要著重之科技領域

我們正在尋找以下科技領域的產品、平台或方案：



半導體

- 記憶體
- 邏輯
- 封裝
- 設備



面板技術

- AR/VR
- 軟性面板
- OLED
- Micro LED



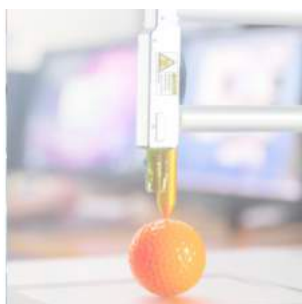
人工智慧 & 大數據

- AI 訓練
- 推論型 AI 晶片
- 自駕車
- 資料分析



生命科學

- 檢測
- 醫療器材
- 影像分析
- 製藥



智慧製造

- 機器人
- 3D 列印
- 自動化



能源技術

- 電池
- 智慧玻璃
- 水科技
- 綠能

更多細節，請參考：<https://pitch-challenge.com/>

欲了解更多企業願景，請參考：<http://blog.appliedmaterials.com/> , <http://itic.com.tw>

接受應材創投或創新公司投資將有機會獲得以下資源：



技術及商業指導



客戶介紹



專利申請



技術移轉



產品整合



智慧財產權及法規相關指導



進入企業技術實驗室



投資基金



市場進入策略指導

應材創投 Portfolio



更多詳細資料，請參考：<http://www.appliedmaterials.com/company/applied-ventures/portfolio>

創新公司 Portfolio

UMC



mosa®



Global
Material
Science



Tsubuka
Seiko



Verplex Inc



Sentien



GPM
均豪精密

EPISTAR



Savior
Lifetec



GLOBALTEK



HORNG
SHIUE
HOLDING



SINGTEX®



更多詳細資料，請參考：<http://itic.com.tw/portfolio/>

全球網絡資源



應用材料:
17 國家, 93 地點,
21,000 名員工

創新工業 & 工研院
300+ 投資經驗, 90+ 新創出場,
6,000+ 位專家

在台據點



參賽資格

- 已成立公司或計劃在未來三至六個月內成立，具備合法資格獲得投資。
- 產品或計劃必須和以下科技領域具關聯性：半導體、人工智慧&大數據、智慧製造、面板技術、能源技術及生命科學。
- 參賽新創必須符合以下：在台灣創立、駐點於台灣，或是已經/將與台灣市場及產業密集合作。
- 未曾接受應材創投或創新公司投資。
- 參賽者必須符合台灣法定創業和成立公司之年齡。

申請參賽

- The 2019 Deep Tech Challenge 已開放報名，可前往[活動網站](#)填寫報名表。
- 在繳交的商業執行計畫中，請務必包含：團隊背景、產品和/或服務的敘述、市場說明、競品及差異性、資金紀錄和規劃。
- 有任何問題，歡迎至[活動專頁](#)與我們聯繫。

重要時程

- 開放報名日期：2019 年 8 月 12 日（一）
- 說明會：2019 年 9 月 17 日（二）、9 月 25 日（三）、9 月 26 日（四）、9 月 27 日（五）
報名連結：<https://pse.is/H6JD4>
- 報名截止日期：2019 年 10 月 11 日（五）
- 決賽團隊公佈日期：2019 年 10 月 25 日（五）
- 簡報訓練日期：2019 年 11 月 5 日（二）
- 決賽簡報日：2019 年 11 月 12 日（二）

請注意：

當主辦方收到資料後，經審核後的參賽者將有機會被要求提供更多補充資料，或是收到主辦方通知。

另外，也請勿向主辦方透露任何機密訊息。

By submitting this form, you agree and represent to us that any information or data that you provide to us ("Information") is considered non-confidential and non-proprietary to you or any other party, and Applied Materials & ITIC have no obligation towards you or any other party to protect such information. Any information you transmit shall be considered non-confidential and non-proprietary information regardless if marked "confidential" or "proprietary." Applied Materials & ITIC will have no obligation of any kind with respect to such information. By communicating with Applied Materials & ITIC, you acknowledge and agree to the foregoing terms. If, after consideration of your non-proprietary disclosure, we wish to have further discussions, we may wish to enter into a confidentiality agreement with you.

Applied Materials & ITIC reserves the right to review the entrant's eligibility at any time and to revoke the entrant's participation in the competition by providing false information, violation of the terms and conditions of the contest, violation of relevant laws, or disruption of the competition process.

Applied Materials & ITIC reserves the right, in its sole discretion, to replace all or part of the reward or investment, and the winning team is not entitled to any additional compensation in this case. Awards or investments may not be transferred or exchanged. Applied Materials & ITIC reserves the right, in its sole discretion, to modify, suspend, terminate or cancel the competition and/or the terms of the competition, to the fullest extent permitted by law, if the competition cannot be reasonably foreseen and reasonably controlled by Applied Materials & ITIC. Applied Materials & ITIC makes no representations or warranties, express, implied, statutory or otherwise, to the contest's rewards or investments and is not liable for any breach of any statement or warranty.



主辦單位/ 應材創投 創新工業技術移轉股份有限公司
協辦單位/應用材料 工業技術研究院 TechOrange 科技報橘
活動支援/ 台灣科技大學創新育成中心

Applied Materials & ITIC

appliedmaterials.com / ITIC.com.tw



© 2016 Applied Materials, Inc. All rights reserved. Applied Materials, the Applied Materials logo and other trademarks so designated or otherwise indicated as product names or services, are trademarks of Applied Materials, Inc. in the U.S. and other countries. All other trademarks contained herein are the property of their respective owners.

